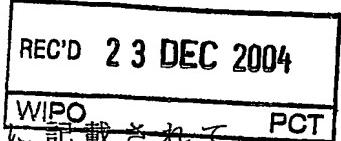


29.10.2004

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application: 2003年12月 1日

出願番号 Application Number: 特願2003-401657

[ST. 10/C]: [JP2003-401657]

出願人 Applicant(s): 三菱住友シリコン株式会社

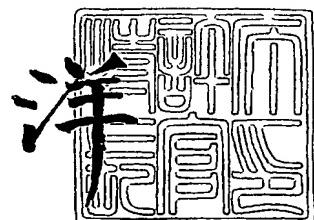
BEST AVAILABLE COPY

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年12月13日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 P02ML056K
【提出日】 平成15年12月 1日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H01L 21/306
H01L 21/304 622

【発明者】
【住所又は居所】 東京都港区芝浦一丁目 2番 1号 三菱住友シリコン株式会社内
【氏名】 古屋田 栄

【発明者】
【住所又は居所】 東京都港区芝浦一丁目 2番 1号 三菱住友シリコン株式会社内
【氏名】 高石 和成

【特許出願人】
【識別番号】 302006854
【氏名又は名称】 三菱住友シリコン株式会社

【代理人】
【識別番号】 100085372
【弁理士】
【氏名又は名称】 須田 正義

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 003285
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲**【請求項1】**

複数のエッティング槽に酸エッティング液とアルカリエッティング液をそれぞれ貯え、ラッピング工程を経て加工変質層を有するシリコンウェーハを酸エッティング液とアルカリエッティング液とに順次浸漬して加工変質層を除去するエッティング工程(14)と、

前記エッティング工程の後に、前記ウェーハの表裏面を同時に研磨する両面同時研磨工程(16)と

を含むシリコンウェーハの製造方法において、

前記エッティング工程(14)のアルカリエッティング液に40～60重量%水酸化ナトリウム水溶液を用い、

前記両面同時研磨工程(16)で前記ウェーハの表面における研磨代Aを5～10μmとし、前記裏面における研磨代Bを2～6μmとし、前記研磨代Aと前記研磨代Bとの差(A-B)を3～4μmとする

ことを特徴とするシリコンウェーハの製造方法。

【請求項2】

エッティング工程(14)が酸エッティングの後にアルカリエッティングが行われる請求項1記載の製造方法。

【請求項3】

酸エッティング槽の数を1～3槽とし、アルカリエッティング槽の数を1～3槽とする請求項1又は2記載の製造方法。

【請求項4】

酸エッティング液がフッ酸、硝酸、酢酸及び水をそれぞれ含む請求項1ないし3いずれか1項に記載の製造方法。

【請求項5】

シリコンウェーハの抵抗値が1Ω・cm未満であるとき、フッ酸、硝酸、酢酸及び水の混合割合が重量比でフッ酸：硝酸：酢酸：水=1：1～5：3～8：3～7である請求項4記載の製造方法。

【請求項6】

シリコンウェーハの抵抗値が1Ω・cm以上であるとき、フッ酸、硝酸、酢酸及び水の混合割合が重量比でフッ酸：硝酸：酢酸：水=1：5～9：1～6：1～5である請求項4記載の製造方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】シリコンウェーハの製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、ウェーハ画面が高精度の平坦度及び小さい表面粗さを有しあつウェーハの裏面を目視により識別可能な片面鏡面ウェーハであって、ステッパチャック等に保持した際の平坦度に優れたシリコンウェーハの製造方法に関するものである。

【背景技術】

【0002】

一般に半導体シリコンウェーハの製造工程は、引上げたシリコン単結晶インゴットから切出し、スライスして得られたウェーハを、面取り、機械研磨（ラッピング）、エッチング、鏡面研磨（ポリッシング）及び洗浄する工程から構成され、高精度の平坦度を有するウェーハとして生産される。

ブロック切断、外径研削、スライシング、ラッピング等の機械加工プロセスを経たシリコンウェーハは表面にダメージ層即ち加工変質層を有している。加工変質層はデバイス製造プロセスにおいてスリップ転位等の結晶欠陥を誘発したり、ウェーハの機械的強度を低下させ、また電気的特性に悪影響を及ぼすので完全に除去しなければならない。

【0003】

この加工変質層を取除くため、エッチング処理が行われる。エッチング処理には、酸エッチング液を用いる酸エッチングと、アルカリエッチング液を用いるアルカリエッチングとがある。

しかし、酸エッチングを行うことにより、ラッピングで得られた平坦度が損なわれ、エッチング表面にmmオーダーのうねりやピールと呼ばれる凹凸が発生する。また、アルカリエッチングを行うことにより、局所的な深さが数 μm で、大きさが数～数十 μm 程度のピット（以下、これをファセットという。）が発生する等の問題点があった。

【0004】

上記問題点を解決する方法として、図7に示すように、単結晶インゴットをスライス1して得た半導体ウェーハを、少なくとも面取り2、ラッピング3、エッチング4、5、鏡面研磨6及び洗浄する工程からなる半導体ウェーハの加工方法において、エッチング工程をアルカリエッチング4の後、酸エッチング5を行うものとし、その際、アルカリエッティング4のエッティング代を、酸エッティング5のエッティング代よりも大きくするウェーハの加工方法及びこの方法により加工されたウェーハが提案されている（例えば、特許文献1参照。）。

上記特許文献1に示される方法により、ラッピング後の平坦度を維持することができ、エッティング後のウェーハ表面のうねりを減少させ、局所的な深いピットの発生や表面粗さの悪化を抑えるとともに、パーティクルやステイン等の汚染が発生しにくいエッティング表面を持つ化学エッティングウェーハを作製することが可能となる。このようなウェーハは鏡面研磨での取り代を減少でき、その平坦度も向上する。

【特許文献1】特開平11-233485号公報（請求項1、段落[0042]）

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、上記特許文献1に示されたウェーハの表面に鏡面研磨6を施したウェーハ（以下、PW；Polished Waferという。）では、デバイスマーカーの所望するような良好な平坦度を有し、かつPWの裏面粗さが小さいウェーハを得られることができない問題があった。

【0006】

一方、デバイスマーカーではデバイスの高集積化に伴い、リソグラフィー工程でデバイスを作り込む際に、ステッパ（露光装置）内にウェーハを保持した状態におけるウェーハ平坦度（以下、チャック時の平坦度という。）を考慮する必要性が増している。ステッパ

内ではウェーハを保持するためにステッパチャックにウェーハを吸着させているため、このステッパチャックのウェーハ吸着位置や保持構造、その形状などがチャック時の平坦度に対して影響を与えている。またウェーハではウェーハ表面を鏡面研磨する前のウェーハ外周形状やウェーハの裏面粗さがチャック時の平坦度に影響を与えている。

【0007】

例えば、図8(a)及び図8(b)に示すように、加工変質層を有するウェーハ7からこの加工変質層をエッチング工程により除去する際に、ウェーハ中央部に比べてエッジ部の厚さが薄くなってしまう場合、続く両面同時研磨工程では図8(c)に示すように、両面研磨装置の上定盤の加工圧によってウェーハ表面の形状がウェーハ裏面の形状に倣うように研磨されてしまうため、両面研磨後のウェーハには反りが形成されたようになってしまふ。図8(d)に示すように、このウェーハ7をステッパチャック8に保持すると、エッジ部近傍では平坦を維持することができずウェーハ中央部に比べて反りあがった状態となる。このようにウェーハ中心部とエッジ部とで平坦度が異なると、エッジ部及びその近傍はデバイス作製領域として利用することができないため、歩留まりが低下してしまう不具合があった。

また図9(a)及び図9(b)に示すように、加工変質層を有するウェーハ7からこの加工変質層をエッチング工程により除去する際に、ウェーハ中央部に比べてエッジ部の厚さが厚くなってしまう場合、続く両面同時研磨工程では図9(c)に示すように、両面研磨装置の上定盤の加工圧によってウェーハ表面の形状がウェーハ裏面の形状に倣うように研磨されてしまうため、両面研磨後のウェーハには反りが形成されたようになってしまふ。図9(d)に示すように、このウェーハ7をステッパチャック8に保持すると、エッジ部近傍では平坦を維持することができず、ウェーハ中央部とエッジ部とで平坦度が異なつてしまい、エッジ部及びその近傍はデバイス作製領域として利用することができない不具合が生じていた。

【0008】

本発明の目的は、ウェーハ両面が高精度の平坦度及び小さい表面粗さを有しつつウェーハの表裏面を目視により識別可能な片面鏡面ウェーハであって、ステッパチャック等に保持した状態におけるウェーハ平坦度に優れたシリコンウェーハの製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

請求項1に係る発明は、図1に示すように、複数のエッチング槽に酸エッチング液とアルカリエッティング液をそれぞれ貯え、ラッピング工程を経て加工変質層を有するシリコンウェーハを酸エッティング液とアルカリエッティング液とに順次浸漬して加工変質層を除去するエッティング工程14と、エッティング工程の後に、ウェーハの表裏面を同時に研磨する両面同時研磨工程16とを含むシリコンウェーハの製造方法の改良である。

【0010】

その特徴ある構成は、エッティング工程14のアルカリエッティング液に40～60重量%水酸化ナトリウム水溶液を用い、両面同時研磨工程16でウェーハの表面における研磨代Aを5～10μmとし、裏面における研磨代Bを2～6μmとし、研磨代Aと研磨代Bとの差(A-B)を3～4μmとするところにある。

請求項1に係る製造方法では、水酸化ナトリウム水溶液を用いたエッティング工程14により、研磨前材料の粗さとテクスチャーサイズの制御及び外周形状コントロールを行うことができ、両面同時研磨工程16で表裏面における取り代をそれぞれ規定することにより、ウェーハ両面を高精度の平坦度にすることができ、かつ裏面粗さを低減することができる。またウェーハの表裏面を目視により識別可能な片面鏡面ウェーハを得ることができる。更に、ステッパチャック等に保持した状態におけるウェーハ平坦度に優れたウェーハが得られる。

【0011】

請求項2に係る発明は、請求項1に係る発明であって、エッティング工程14が酸エッチ

ングの後にアルカリエッティングが行われる製造方法である。

請求項2に係る製造方法では、この順にそれぞれエッティングされたウェーハの表面は、形状の大きいファセットが少なくかつ深いピットの発生も抑制される。

【0012】

請求項3に係る発明は、請求項1又は2に係る発明であって、酸エッティング槽の数を1～3槽とし、アルカリエッティング槽の数を1～3槽とする製造方法である。

請求項4に係る発明は、請求項1ないし3いずれか1項に係る発明であって、酸エッティング液がフッ酸、硝酸、酢酸及び水をそれぞれ含む製造方法である。

請求項4に係る製造方法では、上記酸エッティング液を用いることにより、ラッピング後の平坦度を維持するとともに、表面粗さを低減することができる。

【0013】

請求項5に係る発明は、請求項4に係る発明であって、シリコンウェーハの抵抗値が1Ω・cm未満であるとき、フッ酸、硝酸、酢酸及び水の混合割合が重量比でフッ酸：硝酸：酢酸：水=1：1～5：3～8：3～7である製造方法である。

請求項6に係る発明は、請求項4に係る発明であって、シリコンウェーハの抵抗値が1Ω・cm以上であるとき、フッ酸、硝酸、酢酸及び水の混合割合が重量比でフッ酸：硝酸：酢酸：水=1：5～9：1～6：1～5である製造方法である。

【発明の効果】

【0014】

以上述べたように、本発明のシリコンウェーハの製造方法は、複数のエッティング槽に酸エッティング液とアルカリエッティング液をそれぞれ貯え、ラッピング工程を経て加工変質層を有するシリコンウェーハを酸エッティング液とアルカリエッティング液とに順次浸漬して加工変質層を除去するエッティング工程と、エッティング工程の後に、ウェーハの表裏面を同時に研磨する両面同時研磨工程とを含むシリコンウェーハの製造方法の改良であり、エッティング工程14のアルカリエッティング液に40～60重量%水酸化ナトリウム水溶液を用い、両面同時研磨工程16でウェーハの表面における研磨代Aを5～10μmとし、裏面における研磨代Bを2～6μmとし、研磨代Aと研磨代Bとの差(A-B)を3～4μmとすることを特徴とする。

アルカリエッティング液に水酸化ナトリウム水溶液を用いることにより、研磨前材料の粗さとテクスチャーサイズの制御及び外周形状コントロールを行うことができ、両面同時研磨工程で表裏面における取り代をそれぞれ規定することにより、ウェーハ両面を高精度の平坦度にすることができ、かつ裏面粗さを低減することができる。またウェーハの表裏面を目視により識別可能な片面鏡面ウェーハを得ることができる。更に、ステッパチャック等に保持した状態におけるウェーハ平坦度に優れたウェーハが得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0015】

次に本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。

先ず、育成されたシリコン単結晶インゴットは、先端部及び終端部を切断してブロック状とし、インゴットの直径を均一にするためにインゴットの外径を研削してブロック体とする。特定の結晶方位を示すために、このブロック体にオリエンテーションフラットやオリエンテーションノッチを施す。このプロセスの後、図1に示すように、ブロック体は棒軸方向に対して所定角度をもってスライスされる(工程11)。工程11でスライスされたウェーハは、ウェーハの周辺部の欠けやチップを防止するためにウェーハ周辺に面取り加工する(工程12)。この面取りを施すことにより、例えば面取りされていないシリコンウェーハ表面上にエピタキシャル成長するときに周辺部に異常成長が起こり環状に盛り上がるクラウン現象を抑制することができる。続いて、スライス等の工程で生じたウェーハ表面の凹凸層を機械研磨(ラッピング)してウェーハ表面の平坦度とウェーハの平行度を高める(工程13)。ラッピング工程13を施したウェーハは洗浄工程で洗浄されて次工程へと送られる。

【0016】

次いで、面取り工程12やラッピング工程13により導入された機械的なウェーハ表面の加工変質層をエッチングによって完全に除去する（工程14）。

本発明のエッチング工程14では、複数のエッチング槽に酸エッチング液とアルカリエッティング液をそれぞれ貯え、シリコンウェーハを酸エッチング液とアルカリエッティング液とに順次浸漬する。本発明ではエッチング工程14は酸エッチング14aの後にアルカリエッティング14bが行われる。この順にそれぞれエッチングされたウェーハの表面は、形状の大きいファセットが少なくかつ深いピットの発生も抑制される。

【0017】

酸エッチング14aに用いられる酸エッチング液はフッ酸、硝酸、酢酸及び水をそれぞれ含有する。このような酸エッチング液を用いることにより、ラッピング後の平坦度を維持するとともに、表面粗さを低減することができる。シリコンウェーハの抵抗値が $1\Omega \cdot cm$ 未満の低抵抗品であるとき、フッ酸、硝酸、酢酸及び水の混合割合は重量比でフッ酸：硝酸：酢酸：水=1：1～5：3～8：3～7となるように調製する。また、シリコンウェーハの抵抗値が $1\Omega \cdot cm$ 以上の通常抵抗品であるとき、フッ酸、硝酸、酢酸及び水の混合割合は重量比でフッ酸：硝酸：酢酸：水=1：5～9：1～6：1～5となるように調製する。酸エッチング液を上記混合割合に規定したのは、ウェーハの抵抗値によってエッチング速度が変動するためである。ウェーハの抵抗値が低抵抗になるほど酸エッチング液によるエッチング速度が大きくなる傾向がある。具体的には、抵抗値が $1\Omega \cdot cm$ 未満の低抵抗ウェーハに酸エッチングを施す際に、酸エッチング液を通常抵抗品に用いる酸エッティング液と同程度の混合割合にすると、エッチング後のウェーハ外周部がたれてしまい平坦度が低下する不具合がある。そのため抵抗値が $1\Omega \cdot cm$ 未満の低抵抗ウェーハに対しては、抵抗値が $1\Omega \cdot cm$ 以上の通常抵抗ウェーハに対応する酸エッティング液の混合割合に比べて、硝酸割合を低下させるとともに、酢酸及び水の割合を増加させ、酸エッティング液によるエッチング速度を適度の速度に制御している。ウェーハの抵抗値が $0.01\Omega \cdot cm$ 以下であるときの酸エッティング液の好ましい混合割合は重量比でフッ酸：硝酸：酢酸：水=1：1～3：5～7：4～6である。また、ウェーハの抵抗値が $0.1\Omega \cdot cm$ 以上であるときの酸エッティング液の好ましい混合割合は重量比でフッ酸：硝酸：酢酸：水=1：6～8：4～6：2～4である。アルカリエッティング14bに用いられるアルカリエッティング液は40～60重量%水酸化ナトリウム水溶液を用いる。このアルカリエッティング液を用いることにより、研磨前材料の粗さとテクスチャーサイズの制御及び外周形状コントロールを行うことができる。水酸化ナトリウム水溶液の濃度は好ましくは50～55重量%、特に好ましくは51重量%である。

【0018】

このエッティング工程14では、酸エッティング槽の数を1～3槽とし、アルカリエッティング槽の数を1～3槽とすることが好ましい。エッティング工程14における酸エッティング14aの合計取り代をシリコンウェーハの表面と裏面を合わせた合計で $5\sim10\mu m$ とし、アルカリエッティング14bの合計取り代をシリコンウェーハの表面と裏面を合わせた合計で $10\sim15\mu m$ とする。酸エッティング14aでの合計取り代は $5\sim7\mu m$ が、アルカリエッティング14bでの合計取り代は $13\sim15\mu m$ がそれぞれ好ましい。酸エッティング14aでの合計取り代が $5\mu m$ 未満であると、後に続くアルカリエッティング14bにて形成されるピットの深さが小さくならないために研磨取り代が大きくなってしまい平坦度を悪化させ易い不具合を生じ、 $10\mu m$ を越えるとうねり（ナノトポグラフィー）が発生し、デバイス作製時に不具合を生じる。アルカリエッティング14bでの合計取り代が $13\mu m$ 未満であると、酸エッティング14aの取り代が大きくなり、うねりの問題が発生し、 $15\mu m$ を越えるとピットの深さが大きくなってしまう不具合を生じる。

【0019】

また、各エッティング工程の間には rinsing 工程を行う必要がある。例えば酸エッティング工程14aとアルカリエッティング14bとの間には、純水 rinsing を施す洗浄工程が設けられる。rinsing 洗浄工程を間に入れることにより、ウェーハに付着した酸やアルカリが洗い落とされるため次に続く工程において、前工程のエッティング槽からの薬液の持込みを防ぐこ

とができ、薬液組成の変動を最小限に抑制することができる。具体的には、図3に示すように、先ず、酸エッティング液23が貯えられたエッティング槽24にウェーハ21を一定時間浸漬した後に、エッティング槽24からウェーハ21を引上げ、次いで純水26が貯えられた水槽27にウェーハ21を浸漬してウェーハに付着した酸を洗い落とす。次に、アルカリエッティング液28が貯えられたエッティング槽29にウェーハ21を一定時間浸漬した後に、エッティング槽29からウェーハ21を引上げ、続いて純水31が貯えられた水槽32にウェーハ21を浸漬してウェーハに付着した酸を洗い落とす。

このようなエッティング工程14を終えたウェーハは洗浄工程で表面に付着した薬液が洗い流されて次工程へと送られる。図2(a)及び図2(b)に示すように、加工変質層を有するウェーハ21に本発明のエッティング工程14を施すことにより、研磨前のウェーハの粗さとテクスチャーサイズの制御及びウェーハ外周部の形状を制御することができる。ウェーハ外周部の形状を制御することで、後工程のデバイス工程でのウェーハ外周部におけるステッパーにチャックした状態におけるウェーハ平坦度を制御することができる。

【0020】

次に、図1に戻って、エッティング工程14を終えたウェーハの表裏面を同時に研磨する両面同時研磨を施す(工程16)。

図4に一般的な両面同時研磨装置40を一部破断して示す。両面同時研磨装置40は、下側の筐体41内の上部に配置された下定盤42と、アーム43に吊り下げられた上定盤44とを有している。下定盤42は図示しないキャリヤを搭載して回転する円盤状体である。両面同時研磨を行うウェーハを図示しないキャリヤに保持されることにより、下定盤42は回転してそのウェーハの下面を両面同時研磨するように構成される。この下定盤42は、上部にサンギヤ48を有する駆動軸48aの外側に、上下一対のペアリング49を介して回転自在に取り付けられる。そして、下定盤42の外側には、インターナルギヤ51が、上下一対のペアリング52を介して回転自在に取り付けられている。

【0021】

下定盤42及びインターナルギヤ51は、それらの下部にそれぞれ設けたギヤ42a及び51aを介して、図示しないモータに接続される。駆動軸48aの上端には、上定盤44を回転駆動するためのドライバ48bが回転自在に設けられており、このドライバ48bは、駆動軸48aの中空内部を同軸状に貫通して伸び、かつ回転自在に支持された内側駆動軸(図示せず)の上端に連結される。この内側駆動軸と駆動軸48aとは、遊星歯車機構(図示せず)等により作動連結されており、ドライバ48bは、駆動軸48aの回転に伴い、遊星歯車機構等を介してサンギヤ48と逆方向に回転するようになっている。

【0022】

上定盤44は、その中央部分にドライバ48bが挿通可能な中心孔44aが形成され、図示しないキャリヤにより保持されたウェーハを上から押圧しながら回転してそのウェーハの上面をラッピングする円盤状体である。この上定盤44は上定盤吊り53によって支持される。具体的には、上定盤44を支持した上定盤吊り53の上面に、ペアリング54が固着され、このペアリング54に、シリンドラ56のロッド56aが挿入される。そして、シリンドラ56が、筐体41に立てられたポール57のアーム43によって支持される。このようにして、上定盤44は上定盤吊り53及びペアリング54を介してシリンドラ56のロッド56aに回転自在に支持される。

【0023】

図5及び図6に示すように、両面同時研磨装置40には、周囲に外歯58aが形成され、内部にウェーハが嵌挿される加工孔58bが形成されたキャリア58が下定盤42と上定盤44との間に取り付けられ、外歯58aが両面同時研磨装置40のインターナルギヤ51及びサンギア48とにそれぞれ噛合し、下定盤42と上定盤44との間に挟まれて自転しつつ公転するように設けられる。

【0024】

そして加工孔58bの間にウェーハを嵌挿し、キャリヤ58の加工孔58bにウェーハ21を保持させた状態でキャリヤ58を回転させ、上定盤44と下定盤42により挟まれ

たウェーハ21の上下両面を両面同時研磨する。このときの両面同時研磨工程16におけるウェーハ21の表面における研磨代Aが5～10μm、裏面における研磨代Bが2～6μm、研磨代Aと研磨代Bとの差(A-B)が3～4μmとなるように制御しながら行う。研磨代Aを5～10μmに規定したのは、研磨代Aが5μm未満であると、製造工程を終えて得られたウェーハ表面が完全な鏡面とはならず、ウェーハ表面にピットが残ってしまう可能性が生じるためであり、研磨代Aが10μmを越えると、ウェーハ外周部にダレが発生し平坦度を劣化させるためである。研磨代Bを2～6μmに規定したのは、研磨代Bが2μm未満であると、裏面粗さの低減が十分ではなくステップチャック上におけるウェーハ平坦度が劣化してしまう、即ち研磨代Bが上記数値未満の軽度の研磨では粗さの低減が不十分であり、研磨代Bが6μmを越えると、ウェーハ裏面が鏡面化されてしまい、表裏面の識別がつかなくなるためである。また、また研磨代Bが大きいと平坦度を劣化させる傾向にある。好ましくはウェーハ21の表面における研磨代Aが7～8μm、裏面における研磨代Bが3～4μm、研磨代Aと研磨代Bとの差(A-B)が4μmとなるように制御する。上記制御を行うことにより、ウェーハ表裏面が識別可能な片面鏡面ウェーハを作製することができ、またウェーハ裏面粗さを最適化することができる。

【0025】

表面及び裏面における研磨取り代を上記範囲にそれぞれ制御するために、例えば、ウェーハに供給する研磨剤の流量を1～20L/分、好ましくは2L/分とし、上定盤44の荷重を50～500g/cm²、好ましくは200g/cm²とし、上定盤回転数と下定盤回転数の比を上定盤：下定盤=1：2～20、好ましくは1：5にする。

【0026】

両面研磨装置の上定盤の加工圧によってウェーハ表面の形状はウェーハ裏面の形状に倣うように研磨されてしまうが、本発明のエッティング工程14によって研磨前のウェーハの粗さとテクスチャーサイズの制御及びウェーハ外周部の形状を制御しているため、図2(c)に示すように、両面同時研磨工程16後のウェーハ21には反りが形成されない。またエッティングを経たウェーハ21に本発明の両面同時研磨工程16を施すことにより、ウェーハ裏面粗さを低減することができ、かつウェーハの表裏面を目視により識別可能な片面鏡面ウェーハとすることができます。

【0027】

その結果、図2(d)に示すように、このウェーハ21をステップチャック22に保持してもウェーハ中心部とエッジ部とで平坦度を維持することができるため、エッジ部及びその近傍についてもデバイス作製領域として利用することができ、歩留まりが向上する。

【図面の簡単な説明】

【0028】

【図1】本発明のシリコンウェーハの製造方法を示す工程図。

【図2】本発明のシリコンウェーハの製造方法を経たウェーハをステップチャックに保持したときのウェーハ断面図。

【図3】本発明のエッティング工程の具体例を示す図。

【図4】両面同時研磨装置の構成を示す正面図。

【図5】加工孔にウェーハを配置したキャリヤが下定盤上に配置された状態を示す平面図。

【図6】キャリアが下定盤と上定盤との間に挟まれた状態を示す縦断面図。

【図7】従来のシリコンウェーハの製造方法を示す工程図。

【図8】エッティングにより中央部に比べてエッジ部の厚さが薄くなったウェーハをステップチャックに保持したときのウェーハ断面図。

【図9】エッティングにより中央部に比べてエッジ部の厚さが厚くなったウェーハをステップチャックに保持したときのウェーハ断面図。

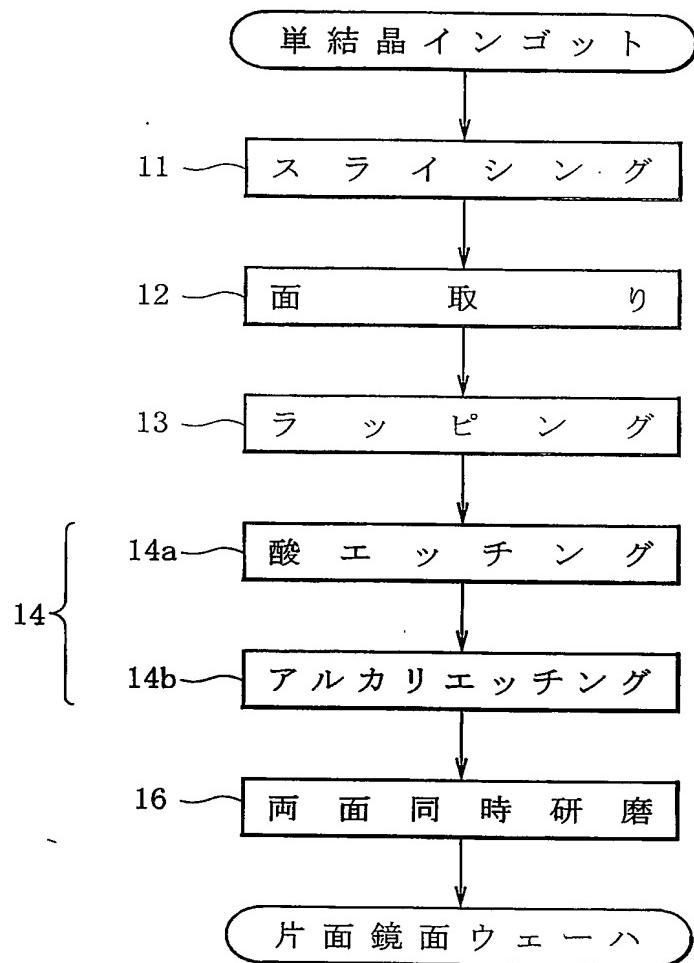
【符号の説明】

【0029】

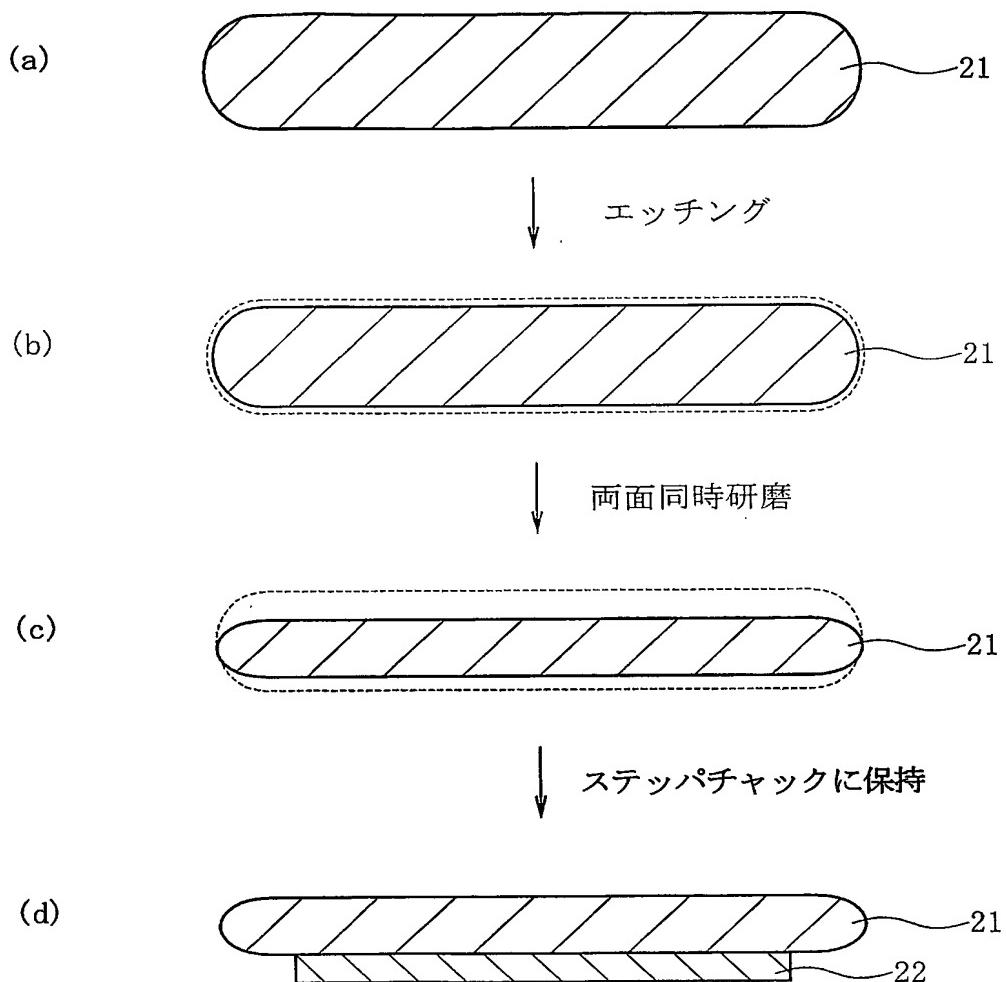
14 エッティング工程

16 両面同時研磨工程

【書類名】図面
【図1】



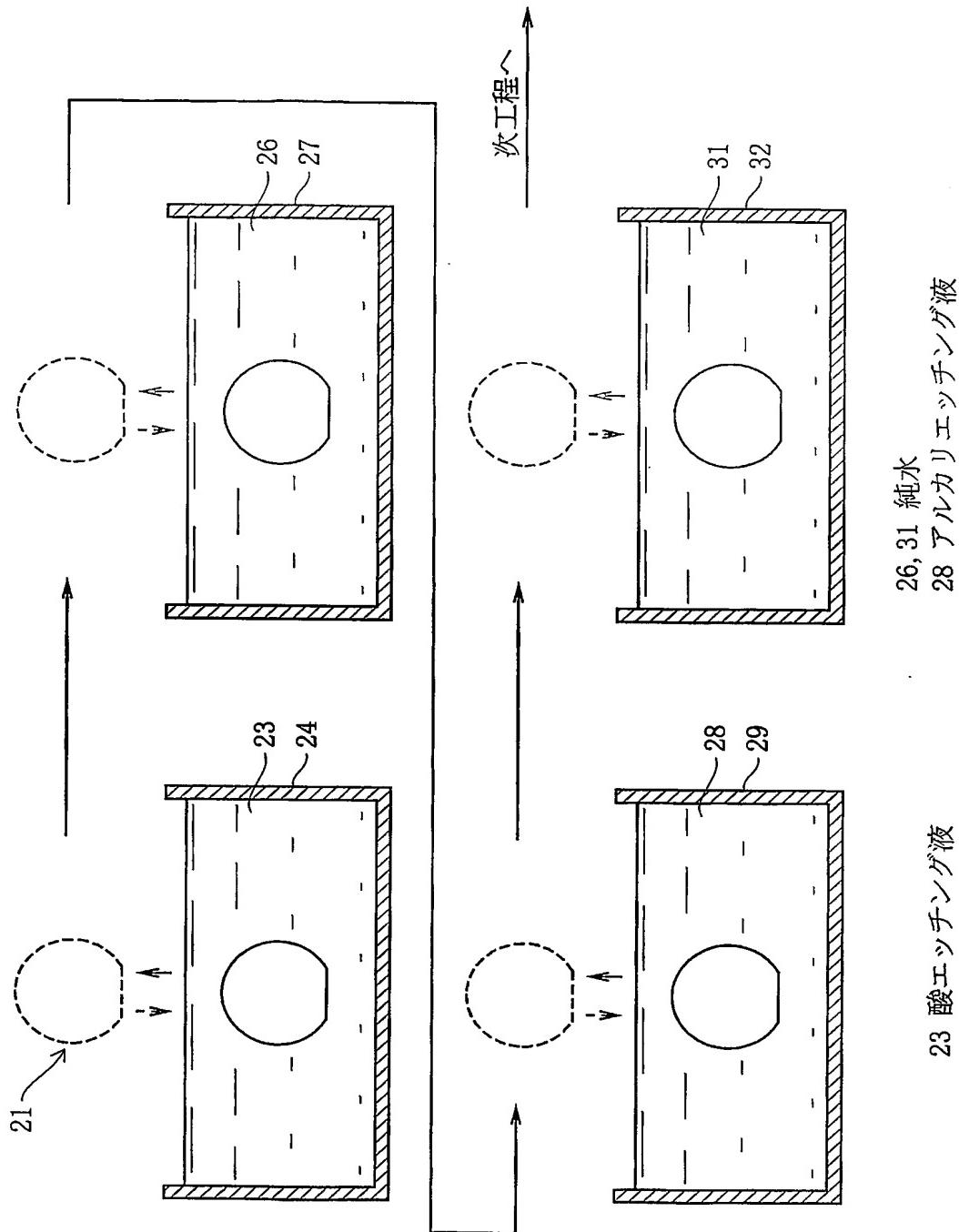
【図2】



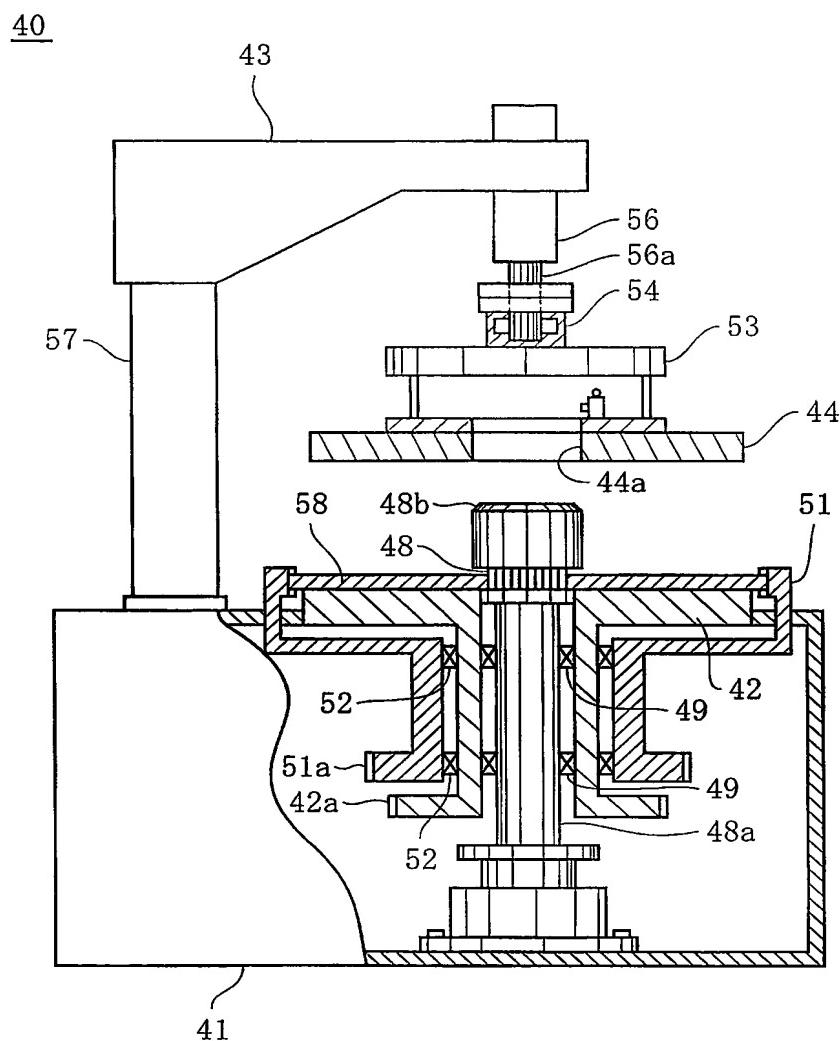
21 シリコンウェーハ

22 ステップパチャック

【図3】



【図4】



40 両面同時研磨装置

42 下定盤

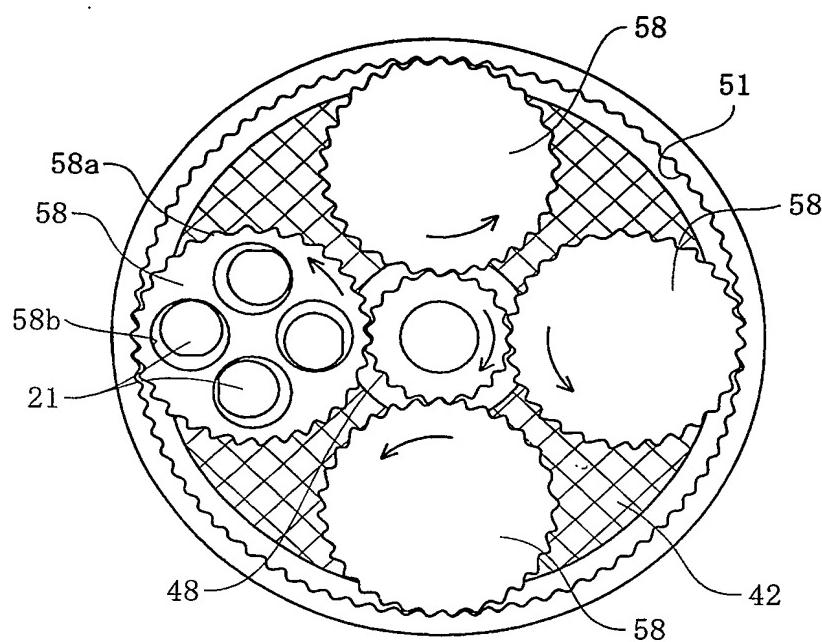
44 上定盤

48 サンギヤ

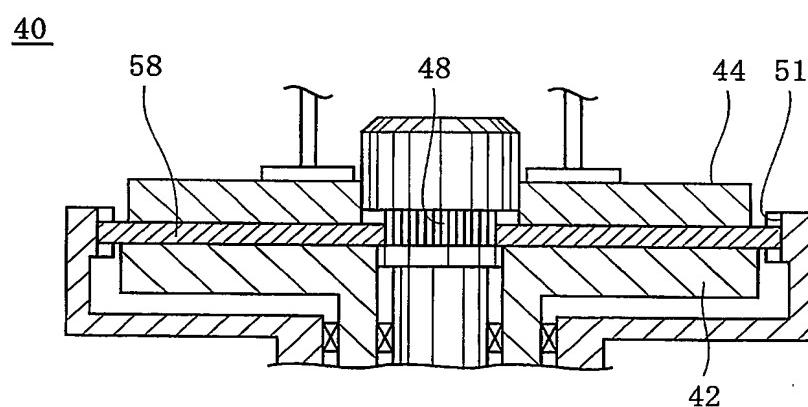
51 インターナルギヤ

58 キャリア

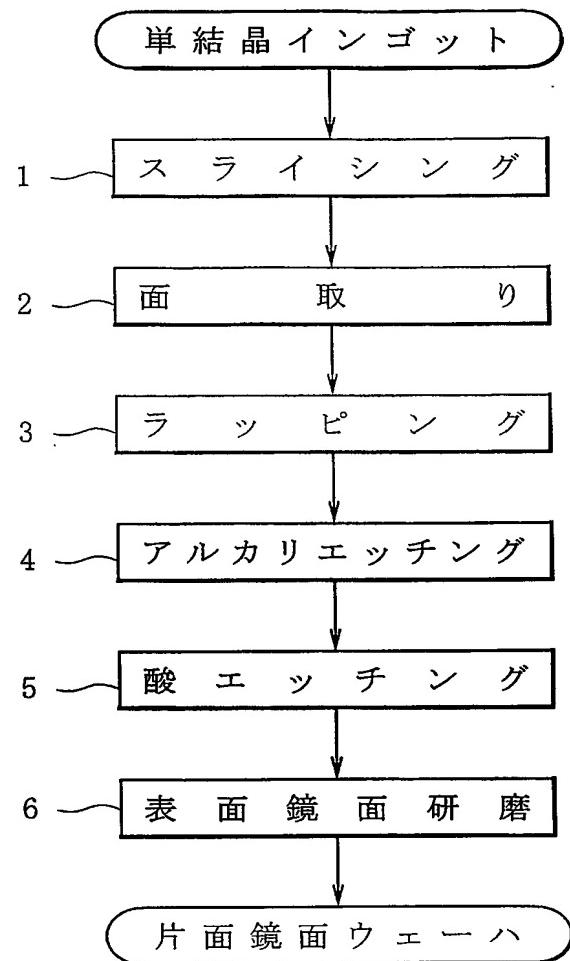
【図5】



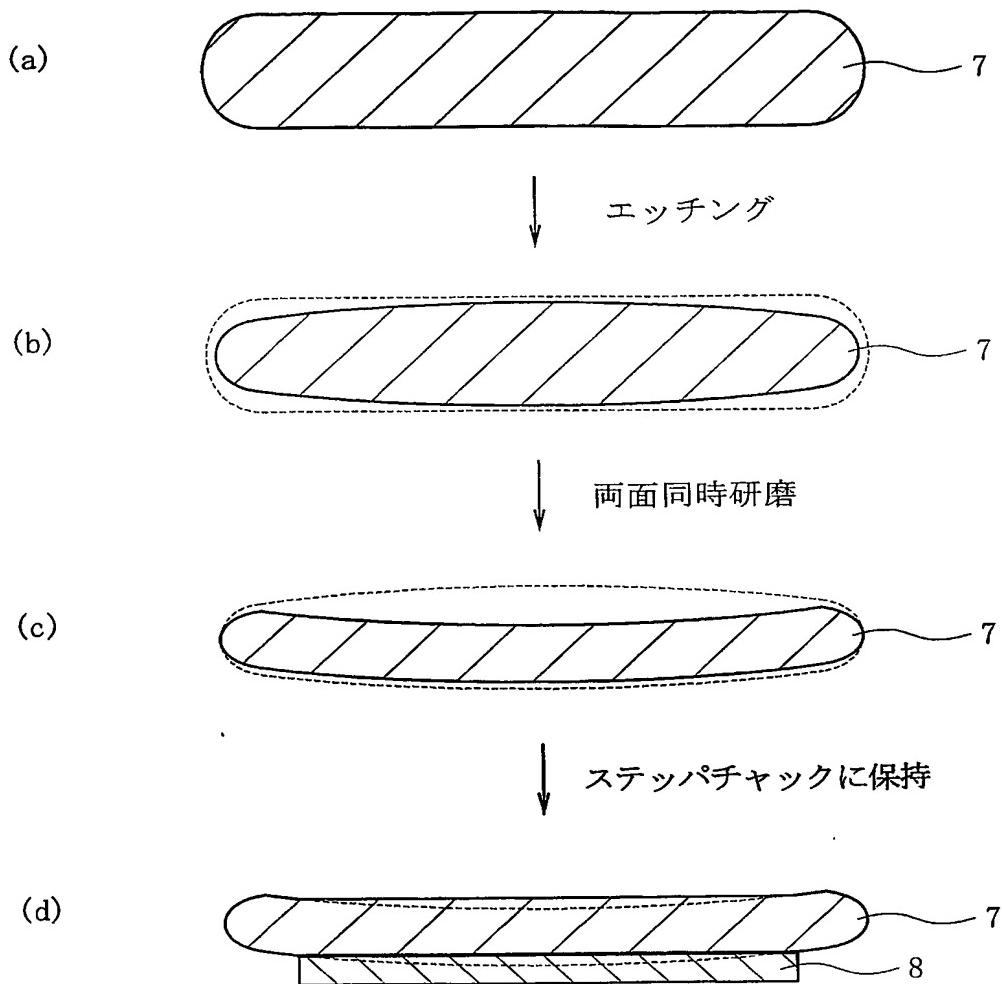
【図6】



【図7】

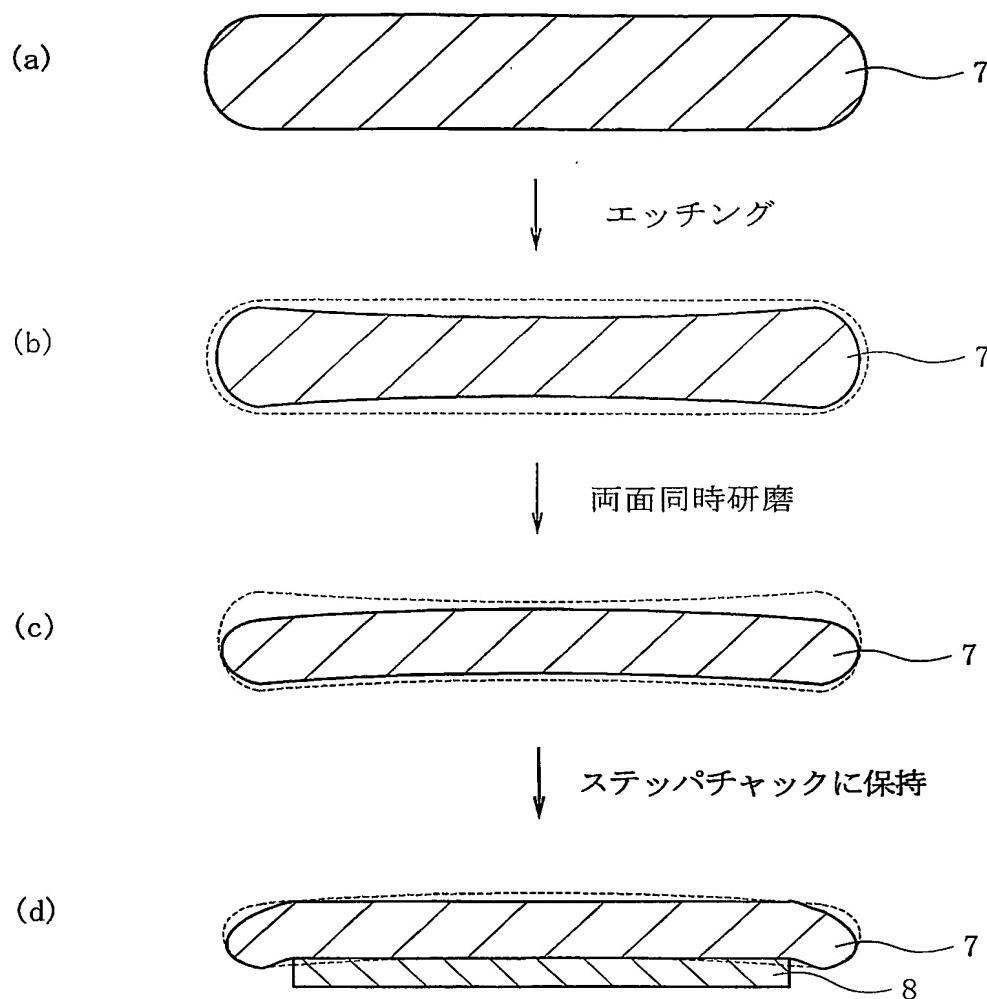


【図8】



7 シリコンウェーハ
8 ステッパチャック

【図9】



【書類名】要約書**【要約】**

【課題】 ウエーハ両面が高精度の平坦度及び小さい表面粗さを有しあつウエーハの表裏面を目視により識別可能な片面鏡面ウエーハであって、ステッパチャック等に保持した状態におけるウエーハ平坦度に優れたシリコンウエーハの製造方法を提供する。

【解決手段】 本発明のシリコンウエーハの製造方法は、複数のエッチング槽に酸エッチング液とアルカリエッチング液をそれぞれ貯え、ラッピング工程を経て加工変質層を有するシリコンウエーハを酸エッチング液とアルカリエッチング液とに順次浸漬して加工変質層を除去するエッチング工程14と、エッチング工程の後に、ウエーハの表裏面を同時に研磨する両面同時研磨工程16とを含み、エッチング工程のアルカリエッチング液に40～60重量%水酸化ナトリウム水溶液を用い、両面同時研磨工程でウエーハの表面における研磨代Aを5～10μmとし、裏面における研磨代Bを2～6μmとし、研磨代Aと研磨代Bとの差(A-B)を3～4μmとすることを特徴とする。

【選択図】 図1

特願 2003-401657

出願人履歴情報

識別番号 [302006854]

1. 変更年月日 2002年 1月31日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都港区芝浦一丁目2番1号
氏名 三菱住友シリコン株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.